



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 引线框



引线框类型: 双列直插式 (DIL)

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 厚度 (已接受) : 1 mm [.039 in]

支座高度: 1.55 mm [.061 in]

引线框压具特性: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
引线框类型	双列直插式 (DIL)

结构特性

卷绕方向	右
------	---

主体特性

引线框夹具长度	1.4 mm[.055 in]
引线框厚度	.25 mm[.01 in]
引线框夹具类型	G1
引线框宽度	18.1 mm[.712 in]
引线框压具特性	不带

接触件特性

端子基材	磷青铜
引线框插针长度	9.1 mm[.358 in]
引线框电镀材料	预镀锡

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----



壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

引线框间隙尺寸	.87 mm[.034 in]
PCB 厚度（已接受）	1 mm[.039 in]
支座高度	1.55 mm[.061 in]

包装特性

封装数量	30000
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1544425-1
CTS 254 BRONZE PRE

客户还购买了



TE 产品编号323030
SPLICE,SOLIS PARA HR 22-16



TE 产品编号34108
SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 8



TE 产品编号169403
LOCATOR

文档

产品图纸

CT DOUBLE INS G

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544443-1_B_c-1544443-1-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544443-1_B_c-1544443-1-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544443-1_B_c-1544443-1-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。